

High-Speed Masseebene Stiftheisen

Technische Daten:

Für eine vollständige Übersicht der technischen Daten siehe www.samtec.com?QTH

Kontaktträger:

Liquid Crystal Polymer

Kontakmaterial:

Phosphor Bronze

Oberfläche:

Au oder Sn über

50 µ" (1.27 µm) Ni

Strombelastbarkeit:

Kontakt:

2 A pro Kontakt

(2 Kontakte belegt)

Masseebene:

25 A pro Masseebene

(1 Masseebene belegt)

Betriebstemperatur:

-55 °C bis +125 °C

Nennspannung:

175 VAC (5 mm Stapelhöhe)

Steckzyklen (max.):

100

RoHS Konform:

Ja

Passende Steckverbinder:

QSH

Passende Kabelkonfektionen:

HQCD, HQDP

(Siehe Hinweis: ebenfalls erhältlich)

Abstandshalter:

SO



ebenfalls erhältlich (Mindestbestellmenge erforderlich)

- Stapelhöhe 15 mm, 22 mm und 30 mm
 - 30 µ" (0.76 µm) Gold (Wählen Sie Kontakmaterial -H für Data Rate Kabelkonfektionen.)
 - Kantenmontage und Führungsposten
 - 80 (-DP), 120, 150 Kontakte pro Reihe
 - Rückhaltestift
- Kontaktieren Sie Samtec.

integrierte
Masseebene

Stapelhöhe
5 mm bis 25 mm

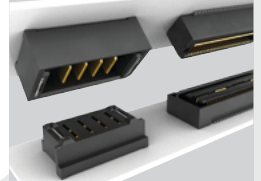
HIGH-SPEED CHANNEL PERFORMANCE

QTH/QSH @ 5 mm Stapelhöhe

Bewertung basiert auf dem Samtec Referenzkanal.
Für die vollständigen SI-Performance Daten
kontaktieren Sie bitte SIG@samtec.com
oder besuchen uns unter www.samtec.com

25
Gbps

Power/Signal Applikation



Kompatibel mit den Serien
UMPT/UMPS für eine
flexible zweiteilige
Power/Signal Lösung

Verarbeitung:

Bleifrei Lötbar: Ja

SMD-Koplanarität:

(0.10 mm) .004" max. (030-060)

(0.15 mm) .006" max. (090)*

*(Bitte kontaktieren Sie

IPG@samtec.com für die

Verfügbarkeit einer .004"

Schablonen Lösung)

Platinenstepelung:

Für Anwendungen, die mehr

als zwei Steckverbinder pro

Platine kontaktieren Sie bitte

ipg@samtec.com

Zertifikate:

Alle Zertifikate finden Sie
unter www.samtec.com/quality



FILE NO. E111594

Anwendungs- hinweise:

- 100 GbE
- Hypertransport™
- XAUI
- PCI Express®
- SATA
- InfiniBand™

QTH	Kontakte pro Reihe Anzahl Signalkontakte	Leiter- form	Kontakt- material	Typ	A	Optionen																								
	- 030, - 060, - 090 (60 Signalkontakte pro Gruppe = -D) - 020, - 040, - 060 (20 Signalkontakte pro Gruppe = -D-DP)	Auswahl der Leiter- form nach der Tabelle	- F = Signalkontakte und Masseebene hauchvergoldet, Anschluss Matt Zinn - L = Signalkontakte und Masseebene 10 µ" (0.25 µm) Gold, Anschluss Matt Zinn - C* = Elektropolierte Teilverguldung min. 50 µ" (1.27 µm) Gold über 150 µ" (3.81 µm) Nickel auf den Signalkontaktpins im Kontaktbereich, min. 10 µ" (0.25 µm) Gold über 50 µ" (1.27 µm) Nickel auf der Groundplane im Kontaktbereich. Mattes Zinn über min. 50 µ" (1.27 µm) Nickel auf allen Lötkontakten	- D = Single- Ended - D-DP = Differential Pair (nur -01)	- K = Ø (7.00 mm) .275" Polyamid Film Pick & Place Pad (nicht mit -05 & -07) - TR = Tape & Reel (max. -090 Kont./Reihe) - L = Verriegelungs- option (nur -01) (nicht mit -60 (-D-DP), & -090)	<table><thead><tr><th>QTH Leiter- form</th><th>A</th><th>Höhe im gesteckten Zustand, mit QSH*</th></tr></thead><tbody><tr><td>- 01</td><td>(4.27) .168</td><td>(5.00) .197</td></tr><tr><td>- 02</td><td>(7.26) .286</td><td>(8.00) .315</td></tr><tr><td>- 03</td><td>(10.27) .404</td><td>(11.00) .433</td></tr><tr><td>- 04</td><td>(15.25) .600</td><td>(16.00) .630</td></tr><tr><td>- 05</td><td>(18.26) .718</td><td>(19.00) .748</td></tr><tr><td>- 07</td><td>(24.24) .954</td><td>(25.00) .984</td></tr><tr><td>- 09</td><td>(13.26) .522</td><td>(14.00) .551</td></tr></tbody></table> *Verarbeitungsprozess kann Höhe im gesteckten Zustand beeinflussen. Siehe SO Serie für Abstandstoleranzen der Leiterplatten.	QTH Leiter- form	A	Höhe im gesteckten Zustand, mit QSH*	- 01	(4.27) .168	(5.00) .197	- 02	(7.26) .286	(8.00) .315	- 03	(10.27) .404	(11.00) .433	- 04	(15.25) .600	(16.00) .630	- 05	(18.26) .718	(19.00) .748	- 07	(24.24) .954	(25.00) .984	- 09	(13.26) .522	(14.00) .551
QTH Leiter- form	A	Höhe im gesteckten Zustand, mit QSH*																												
- 01	(4.27) .168	(5.00) .197																												
- 02	(7.26) .286	(8.00) .315																												
- 03	(10.27) .404	(11.00) .433																												
- 04	(15.25) .600	(16.00) .630																												
- 05	(18.26) .718	(19.00) .748																												
- 07	(24.24) .954	(25.00) .984																												
- 09	(13.26) .522	(14.00) .551																												

Technical drawing of a PCB connector showing dimensions for different pin counts. Dimensions include (7.11) .280, (20.00) .7875, (0.50) .0197, (0.20) .008, and (0.76) .030. It also shows a detail of the pin with dimensions (0.89) .035 and (0.64) .025.

***Achtung:** Kontaktmaterial -C hat den 10 Jahres MFG Test bestanden.

